



## NXP, 미 교통부와 협력 확대로 미래의 스마트 시티 구축 가능한 솔루션 발표

*도시 기반 시설 및 자치 행정 서비스 부문의 스마트 시티 개발에 박차 가하기 위해 미국 교통부와의 협력 확대*

2016년 5월 18일, 서울 - NXP 반도체(NASDAQ: NXPI)는 연례 사용자 컨퍼런스인 NXP FTF 2016에서 엔지니어와 개발자들이 보안 기능을 갖춘 스마트하며 연결된 경험을 개발할 수 있는 새로운 솔루션들을 선보였다. 이번 행사의 핵심 주제는 미래의 스마트 시티로, 이는 민간 및 공공 부문 전반의 복합적인 다양한 수직 산업에서의 사물인터넷(IoT) 기회를 시사한다. UN(United Nations)에 따르면, 2050년경 전 세계 인구의 약 70%는 도시 환경에서 거주하게 될 것으로 예상된다. NXP의 솔루션은 IOT 분야의 까다로운 요구들을 충족하도록 설계되었으며, 사람들이 생활하고 일하며 즐기는 방식을 변화시키고 있다. 도시의 경우, 보다 스마트한 운송 및 교통 시스템, 서비스와 보다 건강한 생활 방식에 대한 시민들의 접근 확대, 디지털화된 인간 상호 작용과 보안을 갖춘 개인적인 데이터의 교환이 이루어지는, 지속적으로 성장하는 사회에서 연결과 보안의 일원화 등을 의미한다.

### 미국 교통부와의 협력 통해 스마트 정부 개발 추진

미국 교통부(U.S. Department of Transportation)는 스마트 시티 챌린지(Smart City Challenge)에 대한 협력을 확대하기로 했으며, 이제 NXP RFID 태깅 솔루션과 스마트 카드 IC까지 포함됐다고 발표했다. 스마트 시티 챌린지에 스마트 NXP RFID 태깅 솔루션이 추가됨에 따라, 자동 차량 식별은 물론 보다 간소화된 교통 요금 결제가 가능해 질 것이다. 스마트 카드 IC는 보다 안전하고 쉬운 전자정부 서비스를 실현할 것이다.

현재까지 NXP는 스마트 시티 챌린지에서 차량 간(V2V: vehicle-to-vehicle) 및 차량과 기반 시설 간(V2I: vehicle-to-infrastructure) 기술, 자동 차량 식별 및 도로 안전 시스템을 위한 장거리 보안 프라이빗 RFID 태깅, 운송, 접근 제어, 소매 및 기타 지방 자치 서비스에 대한 안전한 승인을 실행하는 스마트 카드 IC 등에 참여하고 있다.

### 첨단 스마트 교통

NXP는 새로운 블루박스(BlueBox) 엔진을 활용하고 NXP 칩과 소프트웨어 솔루션을 ADAS 노드에 설치한 제조 가능성이 높은 완전 자율 주행 차량 플랫폼의 데모도 시연했다. 시스템 데모에서는 현재 양산에 착수했거나 고객 대상 샘플링 단계에 있는 NXP 칩을 탑재하고 있는 레이더, 라이다(lidar), 비전 센싱(vision sensing)과 온보드 보안 V2X 시스템을 중앙 컴퓨팅 엔진에 통합했다. NXP의 V2X



기술은 특히 운전자들이 코너 반대 쪽과 앞서가는 대형 트럭과 같은 교통 방해물의 전방을 "볼 수 있도록" 함으로써 차량 속도를 억제하고 사고를 줄일 수 있다는 점에서 스마트 시티에 매우 중요하다.

### **스마트 모빌리티(Smart Mobility) 솔루션으로 시민의 참여 활성화**

NXP는 MIFARE와 NFC 기술을 결합한 다양한 장점들을 소개했다. 플라스틱 카드와 전자 열쇠에서 스마트폰, 스마트 와치 및 기타 웨어러블 기기까지, MIFARE는 공인된 공통 기준이며 대중 교통, 교육 체계, बैंकिंग 및 스마트 유통 등과 같이 보안이 중요한 활용 사례에 최신 암호화 및 보안 인증 방법을 지원할 수 있다. 시연에서는 상호 연결된 스마트 시티에서 MIFARE 및 NFC를 애플리케이션 및 소비자 접점과 연동했다.

### **스마트 머신 및 빌딩용 자연스러운 휴먼 인터페이스 개발 추진**

산업, 의료, 자동차 또는 미디어 집중적인 애플리케이션을 위한 안전한 인간 기계 상호 작용의 가능성을 열고 있는 NXP는 i.MX 8 MEK(Multisensory Enablement Kit)를 발표했다. 강력한 i.MX 8 아키텍처는 엔지니어들이 일상적인 상호 작용을 위해 멀티미디어 및 디스플레이 인터페이스를 검토하고 발전시킬 수 있도록 할 것이다.

### **스마트 홈 및 스마트 라이프를 위한 솔루션 개발 가속화**

NXP는 SCM(단일 칩 시스템 모듈: Single Chip System Modules) 포트폴리오의 신제품인 SCM-i.MX 6SoloX와 V-링크 버스 기술을 발표했다. 이는 공간이 제한된 IoT 애플리케이션에 이상적이며 고객들에게 수직 통합을 위한 새로운 옵션을 제공한다. 고도로 통합된 이들 장치들은 고객의 설계 주기를 단축하고 PCB 공간을 크게 줄이며 단일 솔루션으로 한층 향상된 기능을 제공한다. 또한, NXP는 최대 20 Gbps의 브로드밴드 성능과 추가 온 프레미스 성능의 헤드룸(headroom)으로 스마트 홈 및 스마트 빌딩의 에너지 효율성과 편안함을 높여주는 다양한 애플리케이션을 지원하는 홈 게이트웨이 플랫폼도 발표했다.

NXP는 스마트 게이트웨이, 스마트 '엔드 노드' 장치 및 가전 등을 포함한 스마트 홈 시스템의 개발을 가속화하는 다양한 무선 모듈도 출시했다. 무선 모듈은 FCC/CE/IC의 사전 승인을 받았으며 최신 NXP 지그비 3.0(NXP Zigbee 3.0) 스택과 함께 장착함으로써 고객들이 쉽고 신속하게 새로운 무선 제품을 시장에 출시할 수 있도록 지원한다.

또한, NXP는 미래의 스마트 키친 경험을 실현하는 리드 스테이트 RF 조리 기기를 위한 고성능 구성 요소와 통합 모듈도 발표했다.

### **스마트 전자 지불 개발 주도**

NXP는 스마트 전자 지불 시장에 대한 지원을 확장하고 있으며 고객들이 신속하게 보안 접촉 및 비접촉식 결제 시스템을 개발해 시장에 출시할 수 있도록 돕는 POS(Point-of-Sale) 판독 솔루션 플랫폼인 SLN-POS-RDR을 발표했다. 새롭게 부상하는 전자 지불 시장은 최신 지불 장치에 대해



새롭고 혁신적인 폼팩터, 활용 사례 및 통합 수준을 제시하고 있다. NXP의 입증되고 검증된 POS 판독 솔루션 플랫폼은 개발자들이 즉시 개발 작업에 착수하고 기존의 진입 장벽 없이 혁신에 집중할 수 있도록 한다.

NXP 스마트 시티 및 파트너에 대한 보다 자세한 정보는 웹사이트에서 확인할 수 있다.

NXP FTF 2016에 대한 보다 자세한 정보는 [웹사이트](#)에서 확인할 수 있다.

### **NXP 반도체 소개**

NXP 반도체 (나스닥: NXPI)는 스마트 월드를 위한 시큐어 커넥션 기술을 제공한다. NXP는 임베디드 애플리케이션 용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로, 시큐어 커넥티드 카, 엔드 투 엔드 보안 및 프라이버시, 스마트 커넥티드 솔루션 분야의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 35개 이상의 국가에서 45,000명의 직원을 고용하고 있으며, 2015년 61억 달러의 매출을 기록했다. NXP 관련 뉴스는 [www.nxp.com](http://www.nxp.com)에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (<http://blog.naver.com/nxpkor>) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.